

# 自动开封机decap去封装芯片IC反向失效分析

产品名称	自动开封机decap去封装芯片IC反向失效分析
公司名称	仪准科技（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区软件园广场
联系电话	01082825511-728 13488683602

## 产品详情

### IC酸开封机

SESAME 707/777Cu混合酸开封系统关键应用：快速的IC蚀刻时间

即使是最易损坏的器件也能容易的开封 设计紧凑，占地面积小 专为铜线器件的开封设计（SESAME 777Cu）

SESAME 707/777Cu是一个自动的混合酸开封系统，集成了先进的特色来提高生产效率。开封机可以快速容易的打开任何器件，即使是最易损坏的器件。通过精确的控制硝酸、硫酸混酸，不会造成对器件的损坏。可以选择一个独特的供酸功能，它能够在少于最大的酸消耗量时提供最高的脉冲率。SESAME 707/777Cu可以加热到最高250℃，提供任意种类的酸的配比，使得操作更多样化。

整体刻蚀头由高级碳化硅加工而成，具有超强的耐酸性。

样品固定装置采用气动装置激活，并且设计了无限次往复运动的能力。SESAME

707/777Cu是唯一在酸瓶和开封机之间包含了对所有的液体联轴器的真正的双重节制的开封机。在酸瓶容器系统和刻蚀单元上都有流量传感器，用于警告操作员在机器内部或酸瓶系统出现的任何酸的意外泄漏。